

■PRF18/21\_471Qシリーズ

No.	項目	規格	試験条件									
1	抵抗値 (at 25℃)	定格値を満足すること。	周囲温度25℃において、最大電圧3分印加後、室温 (25℃) に2時間放置した後、DC1.5V以下 (測定電流10mA以下) の端子電圧で測定します。									
2	端子電極固着力	端子電極の剥離または、その徴候は起きません。	参照規格: IEC 60068-2-21 (2006) ・前処理: 試料を評価基板に実装 (**) ・押し力: 5N ・保持時間: 10±1秒									
3	振動	試験後素子の外観に異常はありません。 25℃における抵抗値の変化率は、初期値の±20%以内にありまます。(*)	参照規格: IEC 60068-2-6 (2007) ・前処理: 試料を評価基板に実装 (**) ・周波数: 10~55Hz ・振幅: 1.5mm ・掃引速度: 1オクターブ/min. ・試験方向: 3方向 (X, Y, Z) ・掃引サイクル数: 24回/方向									
4	はんだ付け性	端子電極の95%以上に切れ目なくはんだが付着します。	参照規格: IEC 60068-2-58 (2004) ・はんだ: Sn-3.0Ag-0.5Cu ・はんだ温度: 245±5℃ ・浸漬時間: 3±0.3秒									
5	はんだ耐熱性	試験後素子の外観に異常はありません。 25℃における抵抗値の変化率は、初期値の±20%以内にありまます。(*)	参照規格: IEC 60068-2-58 (2004) [はんだ槽浸漬試験] ・はんだ: Sn-3.0Ag-0.5Cu ・予熱: 150±5℃, 90~120秒 ・はんだ温度: 260±5℃ ・浸漬時間: 10±1秒									
6	高温放置	試験後素子の外観に異常はありません。 25℃における抵抗値の変化率は、初期値の±20%以内にありまます。(*)	参照規格: IEC 60068-2-2 (2007) ・前処理: 試料を評価基板に実装 (**) ・試験環境: +150±2℃ ・試験時間: 1000+48/-0時間									
7	低温放置		参照規格: IEC 60068-2-1 (2007) ・前処理: 試料を評価基板に実装 (**) ・試験環境: -20±3℃ ・試験時間: 1000+48/-0時間									
8	高温高湿放置		参照規格: IEC 60068-2-67 (1995) ・前処理: 試料を評価基板に実装 (**) ・試験環境: +40±2℃, 90±5%RH ・試験時間: 500+24/-0時間									
9	熱衝撃		参照規格: IEC 60068-2-14 (2009) [試験Na: 温度急変] ・前処理: 試料を評価基板に実装 (**) ・移し換え時間: 10秒間以内 ・試験条件: 以下参照 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>段階</th> <th>温度(℃)</th> <th>時間(分)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>-20±3℃</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>+150±2℃</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table>	段階	温度(℃)	時間(分)	1	-20±3℃	30	2	+150±2℃	30
段階	温度(℃)		時間(分)									
1	-20±3℃	30										
2	+150±2℃	30										
10	高温負荷	参照規格: IEC 60068-2-2 (2007) ・前処理: 試料を評価基板に実装 (**) ・試験環境: +85±2℃ ・試験負荷: 最大電圧を連続印加 ・試験時間: 1000+48/-0時間										

\*: 抵抗値測定は、1.5V以下 (測定電流10mA以下) の直流電圧で行います。

試験後の抵抗値測定は、25±2℃中に2時間放置後行います。

\*\* : 評価時のはんだ付けは、「使用上の注意」に記載の標準ランド寸法のガラスエポキシ基板に、弊社標準評価はんだを用い、標準のはんだ付け条件により行っています。